台灣積體電路製造股份有限公司

民國一百年度
營運報告

●台積公司股票在台灣證券交易所（TWSE）掛牌上市，股票代號為2330。

●台積公司股票的美國存託憑證（ADR）以TSM為代號，在美國紐約證券交易所（NYSE）掛牌上市。

台積公司願景與核心價值

願景

成為全球最先進及最大的專業積體電路技術及製造服務業者，並且與我們無晶圓廠設計公司及整合元件製造商的客戶群共同組成半導體產業中堅強的競爭團隊。

為了實現此一願景，我們必須擁有三位一體的能力：
(1) 是技術領導者，能與整合元件製造商中的佼佼者匹敵；
(2) 是製造領導者；
(3) 是最具聲譽、以服務為導向，以及客戶最大整體利益的提供者。

核心價值

誠信正直

這是我們最基本也是最重要的理念。我們說真話；我們不誇張、不作秀；對客戶我們不輕易承諾，一旦做出承諾，必定不計代價，全力以赴；對同業我們在合法範圍內全力競爭，我們也尊重同業的智慧財產權；對供應商我們以客觀、清廉、公正的態度進行挑選及合作。在公司內部，我們絕不容許貪污；不容許有派系；也不容許「公司政治」。我們用人的首要條件是品格與才能，絕不是「關係」。

承諾

台積公司堅守對客戶、供應商、員工、股東及社會的承諾。所有這些權益關係人對台積公司的成功都相當重要，台積公司會盡力照顧所有權益關係人的權益。同樣地，我們也希望所有權益關係人能對台積公司信守其承諾。

創新

創新是我們的成長的泉源。我們追求的是全面，涵蓋策略、行銷、管理、技術、製造等各方面的創新。創新不僅僅是有新的想法，還需要執行力，做出改變，否則只是空想，沒有益處。

客戶信任

客戶是我們的夥伴，因此我們優先考慮客戶的需求。我們視客戶的競爭力為台積公司的競爭力，而客戶的成功也是台積公司的成功。我們努力與客戶建立深遠的夥伴關係，並成為客戶信賴且賴以成功的長期重要夥伴。

目錄

1. 致股東報告書 2

2. 公司簡介與市場概況 6

3. 公司治理 14

4. 營運概況 18

5. 企業社會責任 22

6. 堅實穩健的財務基礎 28

1. 致股東報告書

各位股東女士、先生：

民國一百年對全球半導體市場而言，是個充滿挑戰性的一年。全球半導體市場的成長趨近於零，且對於當年度的景氣展望，也隨著時日推進而越趨疲弱。然而，民國一百年台積公司的營收以美金計價仍呈現9.2%的成長率，市場佔有率更較前一年為高；此成長動力主要來自於台積公司在先進技術上的領導地位，以及因行動運算產品的高度成長，使得台積公司的先進技術被廣泛應用。不畏外在營運環境的挑戰，台積公司仍成功的擴大深耕業務，迅速提高40奈米製程技術的市場佔有率，將28奈米製程技術導入量產，並持續開發20奈米製程技術的能力。具體而言，台積公司民國一百年的成就包括：

- 晶圓出貨量達1,255萬片八吋晶圓約當量
- 先進製程技術（65奈米及其以下更先進製程）的銷售金額達到佔總體晶圓銷售金額的55%
- 為積體電路製造服務業中第一家提供28奈米製程技術量產的公司，率先提供28奈米高介電層／金屬閘（HKMG）技術

財務表現

台積公司民國一百年全年合併營收為新台幣4,270億8,000萬元，較前一年的4,195億4,000萬元增加1.8%；稅後淨利為新台幣1,342億元，每股盈餘為新台幣5.18元，較前一年稅後淨利1,616億1,000萬元及每股盈餘6.23元均減少了17%。

若以美元計算，台積公司民國一百年全年合併營收為145億4,000萬美元，稅後淨利為45億7,000萬美元，而前一年度的全年合併營收為133億2,000萬美元，稅後淨利則是51億3,000萬美元。

台積公司民國一百年毛利率為45.4%，前一年為49.4%；民國一百年營業利益率為33.1%，前一年則為37.9%。民國一百年之稅後純益率則為31.4%，較前一年的稅後純益率減少7.1個百分點。

技術發展

民國一百年，客戶28奈米產品試製（tape-outs）數量創新高，台積公司優異的28奈米後閘極（Gate-Last）高介電層／金屬閘（HKMG）邏輯製程技術邁入量產。民國一百年第四季，28奈米製程技術對營收的貢獻達到2%，並預期於民國一百零一年達到全年約10%。20奈米技術發展亦按照計劃進行，預計於民國一百零一年下半年進入試產；同時，我們亦於民國一百年第三季完成了全球第一個20奈米ARM-Cortex A15 MP核心處理器的產品試製，提供未來行動運算產品高效能的晶片。此外，在經過過去三年的探索研究之後，我們於民國一百年下半年已全面開始14奈米製程技術的研究發展，並已成功展現了28奈米及20奈米極佳的三維鰭式場效電晶體（FinFET）技術能力。

在我們全力推進積體電路發展的同時，亦試圖有效展現系統整合的潛力，以三維（3D）的晶片堆疊做系統整合，並將應用於未來行動產品。民國一百年，我們採用台積公司自有的Chip on Wafer on Substrate（CoWoS™）技術，成功完成了結合邏輯晶片及內建被動元件與凸塊（Bumps）的全功能模組系統，由台積公司製造與封裝。此CoWoS™技術基本上較其他三維的晶片堆疊方式有更好的成本、良率、可靠性，同時全程的整合性也較高；我們已持續和先進開發的夥伴們密切合作，預計將於民國一百零一年獲得產品認證，而後於民國一百零二年開始生產；預期將會在28奈米製程技術開始使用，並成為20奈米及更先進製程技術重要的一環。

企業發展

民國一百年八月，為加強新事業的開創精神，台積公司遂將其成立為兩家百分之百持股的子公司－台積太陽能股份有限公司與台積固態照明股份有限公司，此兩家子公司在技術發展及試產上都表現得相當好。

榮譽與獎項

民國一百年，台積公司在公司治理、法人關係、永續經營、創新以及企業整體表現方面，獲得了許多榮譽與獎項。除了獲得來自*Corporate Governance Asia*、*Institutional Investors*、*IR Magazine*、*IR Global Ranking*所頒發的肯定之外，台積公司亦獲*天下雜誌*頒發天下企業公民獎及台灣最佳聲望標竿企業，及獲政府頒發國家產業創新獎，及善盡企業社會責任的台灣綠色典範獎。此外，民國一百年，台積公司連續第十一年獲選為道瓊永續發展指數的組成企業。

此外，由於台積公司所有全體員工多年來的努力，民國一百年八月，我很榮幸獲頒為國際電機電子工程師學會（IEEE）之2011 IEEE Medal of Honor得主，表彰我在半導體領域新創與推展專業積體電路製造服務、無晶圓廠之積體電路設計公司及虛擬晶圓廠服務的構想。

未來展望

我們相信，在半導體產業的未來十年中，智慧型手機及平板電腦等行動運算產品，將持續扮演著殺手級應用的角色。這些新產品以及得以讓其被廣泛應用之通訊架構的建置，都需要更精密的半導體技術；而我們相信，因台積公司所擁有符合市場需求的先進技術及產能，使我們已站在絕佳位置上，未來將會持續與客戶共享這些市場的成長與成功。台積公司的三大競爭優勢—先進技術、卓越製造、客戶信任，在未來亦將帶領著台積公司繼續成為最先進、最創新、擁有最大產能的積體電路製造服務業者。

張忠謀

張忠謀
董事長暨執行長

2. 公司簡介及市場概況

2.1 公司簡介

台積公司成立於民國七十六年二月二十一日，總部設立於台灣新竹科學工業園區，是全球規模最大的專業積體電路製造服務公司。台積公司開創並專注於生產客戶設計之晶片，身為專業積體電路製造服務公司，台積公司並不設計、生產或銷售自有品牌產品，確保不與客戶競爭。

台積公司的客戶遍布全球，為客戶生產的晶片被廣泛地運用在電腦產品、通訊產品、消費性與其他電子產品等多樣應用領域。

民國一百年，台積公司所擁有及管理的產能達到1,322萬片八吋晶圓約當量。台積公司在台灣設有三座先進的十二吋晶圓廠、四座八吋晶圓廠和一座六吋晶圓廠，並擁有二家海外子公司WaferTech美國子公司、台積電（中國）有限公司及其他轉投資公司之八吋晶圓廠產能支援。

台積公司在北美、歐洲、日本、中國大陸、南韓、印度等地均設有子公司或辦事處，提供全球客戶即時的業務和技術服務。至民國一百年底，台積公司全球員工總數超過3萬3,000人。

台積公司在先進製程技術及「超越摩爾定律」製程技術（More-than-Moore）的發展上持續領先專業積體電路製造服務領域，不僅率先將65奈米和40奈米先進製程技術導入量產，在民國一百年亦提供28奈米全世代製程技術，包括支援高效能表現的28奈米高效能高介電層／金屬閘（簡稱28HP）以及28奈米高效能行動運算製程技術（簡稱28HPM）外，亦提供支援低耗電表現的28奈米低耗電氮氧化矽（簡稱28LP）製程技術及28奈米低耗電高介電層／金屬閘（簡稱28HPL）技術，提供客戶更完備的28奈米製程技術選擇。同時，亦在民國一百年年底進入20奈米製程投片生產。除了一般邏輯製程技術，台積公司也針對客戶需求提供廣泛的製程技術，例如：嵌入式非揮發性記憶體（Embedded Non-volatile Memory）製程、嵌入式動態隨機存取記憶體（Embedded DRAM）製程、混合訊號／射頻（Mixed Signal/RF）製程、高壓（High Voltage）製程、互補金屬氧化物半導體影像感測器（CMOS Image Sensor）、彩色濾光片（Color Filter）、微機電系統（MEMS）、矽鍺（Silicon Germanium）製程以及符合車用電子等級的半導體製造套裝服務（Automotive Service Packages）等。

民國一百年八月，台積公司將太陽能與固態照明二項新事業獨立為二家子公司－台積太陽能股份有限公司與台積固態照明股份有限公司。

台積公司股票在台灣證券交易所上市，股票代碼為2330，另有美國存託憑證在美國紐約證券交易所掛牌交易，股票代號為TSM。

台積公司在業界的領導地位奠基於「先進技術、卓越製造、客戶信任」三位一體的差異化競爭優勢。身為技術領導者，台積公司一直以來均為首家致力研發下一世代先進技術的專業積體電路製造服務公司；身為製造領導者，台積公司以優良的良率管理著稱，並提供加速產品上市及量產的最佳支援服務；在客戶信任上，台積公司也以與客戶緊密無間的合作來提升設計和製造效率。前瞻未來，台積公司將持續藉由三位一體的競爭優勢，提供客戶最有價值的服務。

2.2 台積公司卓越表現

民國一百年，即使面對既有競爭者及新進競爭者的挑戰，台積公司在全球半導體業之積體電路製造服務領域，仍以48%的市場佔有率持續保持領先地位。

擁有最先進的製程技術是台積公司在專業積體電路製造服務領域保持領先地位的重要關鍵。民國一百年，約有73%的營收來自0.13微米及以下更先進的製程；同年八月，更成功締造了45/40奈米十二吋晶圓出貨第一百萬片的新里程碑。同時，台積公司也領先積體電路製造服務領域，提供客戶最先進的28奈米製程服務。截至民國一百年第四季，台積公司已有59%的晶圓製造服務營收來自於65奈米及以下更先進製程。

除了聚焦贏得了客戶信賴外，台積公司於民國一百年亦持續強化「開放創新平台」（Open Innovation Platform®），以提供更多的創新服務。在民國一百年舉辦的台積技術論壇（TSMC Technology Symposium）及IEEE設計自動化會議（Design Automation Conference of IEEE/ACM），台積公司發表了參考設計流程12.0、射頻技術參考設計套件（Radio Frequency Reference Design Kit）第三版、類比混合訊號參考設計流程（Analog Mixed-Signal Reference Flow）第二版，以彰顯透過「開放創新平台」整合設計的成功。於民國一百年十月在美國聖荷西舉行兩天的「開放創新平台生態論壇」（OIP Ecosystem Forum）邀請了客戶及生態產業夥伴共襄盛舉，展示透過「開放創新平台」合作所創造之價值及促進創新之綜效。此外，台積公司之「開放創新平台」的商業模式於民國一百年十二月得到政府所頒發的「國家產業創新獎」之「年度創新領航獎」，更彰顯「開放創新平台」為半導體產業帶來的益處。

台積公司持續提升半導體製程技術，在民國一百年開發和已提供的製程包括：

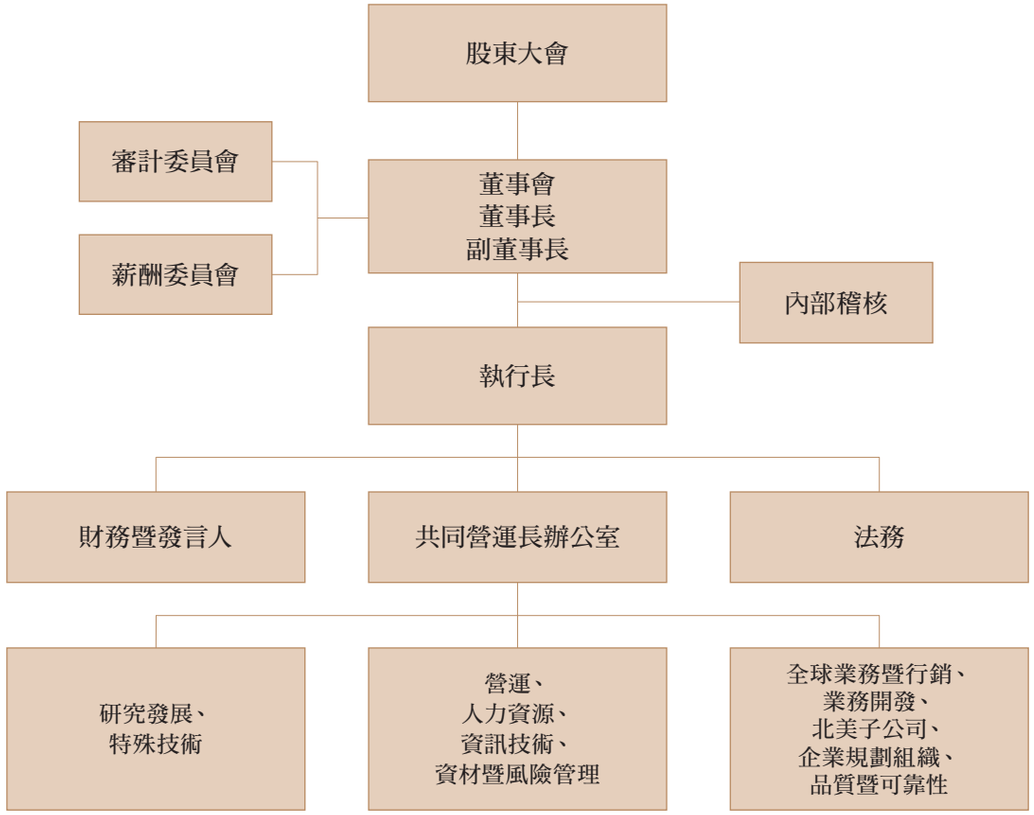
- 發展20奈米製程技術，以提供最佳的速度與功耗比支持像中央處理器（CPU）、圖像處理器（GPU）、加速處理器（APU）及場域可程式化閘陣列（FPGA）性能主導的產品以及行動運算之應用如智慧型手機、平板電腦及高端的系統單晶片（SoC）。
- 28奈米高性能製程技術（28HP）支援中央處理器、圖像處理器、加速處理器、場域可程式化閘陣列及高速網路晶片等性能導向之應用。
- 28奈米高性能行動運算製程技術（28HPM）支援平板電腦、智慧型手機及高端的系統單晶片之應用。
- 28奈米低耗電製程技術（28LP & HPL）及射頻製程技術（28HPL-RF）提供主流智慧型手機、應用處理器（AP）、平板電腦、家庭娛樂及數位消費性電子產品之應用。
- 40奈米泛用型製程技術（40GP）支援中央處理器、圖像處理器、場域可程式化閘陣列、硬碟控制器（HDD）、遊戲機（Game Console）及千兆位元乙太網路控制器（GbE）等性能導向之應用市場。
- 40奈米低耗電及射頻製程技術（40LP & RF）提供手機基頻晶片（Cellular BB）、應用處理器、數位電視（DTV）、機頂盒（STB）、遊戲晶片及無線網路連接產品解決方案。
- 與客戶共同開發40奈米及65奈米非揮發性嵌入式快閃記憶體（eFlash）製程技術以符合高端車用電子應用。
- 55奈米低耗電射頻技術提供無線區域網路（WLAN）、手機基頻晶片、數位電視、機頂盒、藍芽（Bluetooth）、可攜式媒體播放器（PMP）、行動上網裝置（MID）及手持裝置等應用。
- 55奈米及65奈米製程技術以提供無線區域網路、手機基頻晶片、數位電視、機頂盒、藍芽、藍光光碟播放器（Blue-ray DVD）及硬碟控制器等應用。
- 55奈米及85奈米低耗電製程技術支援快閃記憶體控制器（Flash Controller）之應用。
- 80奈米高壓製程支援高畫質（HD720）面板驅動晶片，可讓智慧型手機達到視網膜解析度（RETINA）顯示品質。
- 90奈米嵌入式快閃記憶體技術已通過特定應用積體電路及微控制器晶片應用規格驗證並已量產。
- 0.18微米超低漏電（Extreme Low Leakage，比一般0.18微米製程降低98%漏電電流）的嵌入式快閃記憶體技術已通過對功耗極敏感應用之驗證。
- 0.18微米及0.25微米已通過一次性可程式化快閃記憶體技術驗證，以支援車用電子應用。
- 0.18微米及0.25微米高精度類比製程已經全面釋出給要求性能的類比混合訊號之應用。
- 0.18微米BCD（Bipolar-CMOS-DMOS）新一代的製程技術已進入提供Beta版給客戶支援數位電源管理晶片之階段，讓客戶設計具有競爭優勢的Rdson性能及擁有最佳化的成本架構。

此外，台積公司在民國一百年持續強化特殊製程技術的開發，包括背面照度互補金屬氧化物影像感測器製程（BSI CIS）、90/55奈米嵌入式快閃記憶體製程、0.5微米超高壓功率IC及0.13微米類比製程。民國一百年，台積公司更開始提供三維微機電系統（3D MEMS）平台、厚達30微米之微機電系統架構及晶圓級封裝技術給第一波的無晶圓廠之設計公司。此第一波客戶採用台積公司微機電系統平台整合客製化的驅動晶片於加速度計（Accelerometer）的應用。台積公司將提供全面整合的互補金屬氧化物三維微機電系統（CMOS 3D MEMS）平台及設計準則於民國一百零一年第一季成為標準支援項目。這些特殊製程技術是台積公司與其他競爭者的重要差異，能提供予客戶更多價值。

身為專業積體電路製造服務領域的領導者，台積公司在民國一百年的合併營收約為美金145億元，佔積體電路製造服務領域的48%。依據地區劃分，其中來自北美市場的營收佔台積公司總體營收的69%、日本與中國大陸以外的亞太市場佔14%、歐洲市場佔9%、中國大陸市場佔4%、日本市場亦佔4%。依據終端產品市場來區分，電腦相關產品佔台積公司總體營收的22%、通訊相關產品佔49%、消費性電子產品佔10%、工業用等其他產品則佔19%。

2.3 公司組織及功能介紹

組織圖



註：研究發展資深副總經理蔣尚義博士、營運資深副總經理劉德音博士、業務開發資深副總經理魏哲家博士已於民國一百零一年三月二日被任命為本公司執行副總經理暨共同營運長。三位執行副總經理暨共同營運長，以及「財務」與「法務」兩組織直接對張忠謀董事長暨執行長負責；而本公司其他內部組織單位則改對上述三位執行副總經理暨共同營運長負責。此任命案已於三月五日生效。

組織功能介紹

研究發展
- 先進與主流製程技術研發、先導技術研發、設計服務暨技術平台發展

特殊技術
- 特殊技術業務策略發展與執行

營運
- 產品發展、製造技術、六吋及八吋廠、十二吋廠、協力廠及後段技術暨服務

人力資源
- 人力資源管理與組織發展
- 機密資訊保護

資訊技術
- 技術系統整合、企業系統整合、資訊建構暨通訊服務、資訊技術安全、資訊技術生產力與品質管理

資材暨風險管理
- 採購、倉儲管理、進出口、運籌管理、工業安全、環境保護

全球業務暨行銷
- 品牌管理、市場分析暨預測、客戶服務、日本、亞洲、中國及歐洲子公司業務或服務之營運、技術支援

業務開發
- 行動運算、電腦、消費性電子產品、通訊暨工業電子等相關產品之積體電路製造業務開發；新產品應用暨市場開發及客戶關係強化

北美子公司
- 北美客戶業務、市場發展、技術支援與服務

企業規劃組織
- 營運資源規劃、製造與業務需求企劃、企業流程整合

品質暨可靠性
- 品質與可靠性管理

財務暨發言人
- 公司財務、會計服務、法人關係、公共關係、稅務管理、財務規劃、投資管理、策略規劃
- 公司發言人

法務
- 公司法務、訴訟、商務合約、專利及其他智慧財產權管理、法規遵循

內部稽核
- 內部稽核與作業流程遵循管理稽核

2.4 市場概況

民國一百年，全球半導體市場的產值估計約為美金3,000億元，較民國九十九年成長0.4%。其中，從事半導體製造的積體電路製造服務業產值約為美金280億元，年成長率為4%。民國一百年，積體電路製造服務領域的最大市場（依據客戶總部所在地區）為北美地區，佔全球市場的61%；第二大市場為日本以外的亞太地區，佔28%；其次為歐洲市場佔8%；日本市場則佔3%。

產業未來展望、機會與挑戰

積體電路製造服務市場的需求與供給

積體電路製造服務領域在民國九十九年呈現45%的巨幅成長，於民國一百年僅呈現4%的微幅成長。此乃由於全球經濟景氣趨緩，加上日本地震和泰國水災所引起的供應鏈中斷，導致終端需求疲弱和保守謹慎的庫存管理，使得全球半導體市場成長緩慢，亦對積體電路製造服務業造成影響。

民國一百零一年整體半導體產業預計將成長2%。展望未來，電子產品採用半導體元件的比率提升，無晶圓廠設計公司持續擴大市佔率，及整合元件製造商擴大委外代工，從民國一百年至民國一百零五年，專業積體電路製造服務領域的成長可望較整體半導體產業4%年複合成長率為高。

積體電路製造服務領域位居整個半導體產業鏈的上游，其表現與通訊、電腦、消費性電子產品等主要終端產品的市場狀況息息相關。

● 通訊

民國一百年通訊產業持續成長，尤其在手機方面，達到單位出貨量10%的強健成長。擁有較多半導體組成元件的智慧型手機，更是帶動成長的主要力道。

手機由3G演進至4G/LTE將持續推動市場的成長。民國一百零一年，擁有更高效能、更低耗電及更多智慧型應用的智慧型手機，將更為吸引消費者的購買興趣；同時，較低階的智慧型手機在新興市場國家的普及，亦是持續推動手機市場成長的動力。

低耗電特性的晶片對手機製造商而言是不可缺少的一環。擁有最佳成本、耗電及外型尺寸的系統單晶片，以及對於運算複雜軟體的高效能需求，將加速先進製程技術的推進，而台積公司在先進製程技術方面已居領導地位。

● 電腦

相較於民國九十九年電腦相關領域達到兩位數百分比的成長率，民國一百年，電腦相關領域產品的表現相對疲弱，僅微幅成長2%。主要係因已開發國家的保守支出，以及因平板電腦出現，取代了消費者在電腦上的支出。

展望民國一百零一年，電腦產業將呈現適度成長。雖然受到對未來經濟展望持續悲觀的影響，然因新興國家電腦普及率仍相對較低，依舊可望成為成長的主要動力。創新的產品特性和外型，如輕薄的超極緻筆電（Ultrabook），以及作業系統的更新，亦有助刺激電腦的消費。

隨著對需低耗電、高效能及高整合度的電腦主要半導體元件如中央處理器、繪圖處理器與晶片組等的需求增加，將促使產品設計的需求，朝向先進製程技術發展。

● 消費性電子

歷經民國九十九年的強勁成長後，民國一百年消費性電子業成長動能消退，整體單位出貨量僅增加了1%。對經濟景氣的不確定抑制了消費性電子產品的買氣，亦對許多領域產生影響，如數位電視全年均位於高庫存水位。

展望民國一百零一年，新款遊樂器的推出將帶動電視遊樂器的買氣，而數位機上盒的銷售亦將受惠於多國政府從類比轉換為數位電視廣播的政策及補助。同時，新穎的功能及積極的降價策略也將刺激數位電視、藍光DVD播放器與數位單眼相機的市場銷售量。

此外，數位消費電子產品的創新應用已創造了如觸控螢幕、運動感測、高解析度及3D顯示等在新產品上的整合使用模式，除將提高對先進製程技術的需求外，也將進一步增加對如互補金屬氧化物影像感測器、高壓製程、嵌入式記憶體及微機電製程等「超越摩爾定律」（More-than-Moore）特殊製程的仰賴。台積公司提供的技術全面且完整，以求在新趨勢下持續獲利。

新興應用不斷崛起

新興應用如多媒體平板電腦對積體電路製造服務業的貢獻正在逐漸發酵。在蘋果公司iPad的帶領下，多媒體平板電腦於民國一百年出貨已達6,000萬台，遠高於民國九十九年出貨1,700萬台，強勁的銷售動能在民國一百零一年將隨著其他廠商推出更多機型而持續成長。預期民國一百年至民國一百零五年間，多媒體平板電腦市場將以34%的年平均複合成長率，推動半導體業和積體電路製造服務業持續強勁成長。

產業供應鏈

電子產品的供應鏈不僅複雜冗長，且各個環節環環相扣。作為產業鏈的上游，半導體元件供應商必須提供及時且充足的產能以因應市場的激烈變化，而積體電路製造服務更是確保產業鏈穩健的重要元素。台積公司身為積體電路製造服務領域的領導者，將持續提供最先進的製程技術及充足的產能，以確保整體產業的穩定與持續創新。

3. 公司治理

3.1 董事會

民國一百年，台積公司將董事人數由七位增為九位，並於一百年股東常會增選二名獨立董事。台積公司的董事會現由九位擁有豐富的世界級公司經營經驗或學術經驗的董事所組成，其中五位為獨立董事，分別為：前英國電信公司執行長彼得・邦菲爵士、前宏碁集團董事長施振榮先生、前德州儀器公司董事長湯馬斯・延吉布斯先生、普林斯頓大學教授鄒至莊先生，以及現為中華民國行政院政務顧問及台北市政府市政顧問陳國慈女士。台積公司獨立董事的人數已經超過全體董事席次二分之一。在張忠謀董事長領導下，董事會嚴肅對待它的責任，是一個「認真、有能力、獨立」的董事會。

依張董事長對公司治理的理念，董事會的首要責任是監督。它必須監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有內部貪污等。為了善盡監督責任，台積公司董事會已建立了各式組織與管道，例如：審計委員會、薪酬委員會、隸屬審計委員會的財務專家、內部稽核、內部檢舉系統等。

董事會的第二個責任是指導經營團隊。台積公司董事會每季定期聽取經營團隊的報告，也花相當多時間與經營階層對話，經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，也必須經常檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊作調整。

董事會的第三個責任，是評量經營團隊之績效及任免經理人。台積公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通，專心致力於執行董事會的指示與業務營運，以為股東創造最高利益。

審計委員會及薪酬委員會

審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。其審議的事項包括：公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

審計委員會於其責任範圍內有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請律師、會計師或其他顧問協助其執行職務。

至民國一百零一年二月底止，台積公司審計委員會由全體五位獨立董事組成並聘任一位財務專家。審計委員會組織章程請參考本公司網站。

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。

至民國一百零一年二月底止，薪酬委員會由全體五位獨立董事組成，董事長張忠謀博士應被邀請列席參加所有會議，並於討論其薪酬時予以迴避。薪酬委員會組織章程請參考本公司網站。

3.2 股東會與董事會重要決議事項及執行情形

股東會重要決議事項及執行情形

台積公司民國一百年度股東常會於民國一百年六月九日在新竹舉行。會中出席股東決議通過事項及執行情形如下：

一、承認民國九十九年度之營業報告書及財務報表
執行情形：決議通過

二、核准民國九十九年度盈餘分派之議案
執行情形：決議通過，並已依股東會決議執行完成

三、核准修訂公司內部規章如下：
- 資金貸與他人作業程序
- 背書保證作業程序

執行情形：決議通過，並已依股東會決議執行完成

四、核准將本公司太陽能業務及固態照明業務分別分割讓與即將新設且百分之百持有之兩家子公司，並核准「太陽能事業分割計劃書」及「固態照明事業分割計劃書」
執行情形：決議通過，並已依股東會決議執行完成

五、選舉案：增選二名獨立董事
執行情形：二位新當選獨立董事為鄒至莊先生及陳國慈女士

董事會重要決議事項

本公司於民國一百年度及至民國一百零一年二月二十九日止共召開五次董事常會及二次臨時董事會，重要決議摘要如下：

一、民國一百年二月十四日及十五日董事常會：
- 核准民國九十九年度營業報告書及財務報表；
- 核准民國九十九年度盈餘分派與現金股利、員工現金獎金及員工紅利議案；
- 核准資本預算美金29億元；
- 核准對TSMC Solar North America增資美金500萬元；
- 召集民國一百年度股東常會；
- 決議本公司董事人數為九人，並於民國一百年度股東常會增選兩名獨立董事；及
- 核准擢升林本堅博士為副總經理。

二、民國一百年四月二十七日臨時董事會：
- 核准將符合規定之二位獨立董事被提名人列為本公司民國一百年度股東常會增選二名獨立董事之候選人；及
- 核准將本公司太陽能業務及固態照明業務分割讓與即將新設且百分之百持有之兩家子公司。

三、民國一百年五月九日及十日董事常會：
- 核准資本預算美金15億9,920萬元。

四、民國一百年八月八日及九日董事常會：
- 核准調整本公司分割讓與台積太陽能股份有限公司與台積固態照明股份有限公司之營業價值；
- 核准在國內市場募集無擔保普通公司債，資金額度不超過新台幣350億元；
- 核准擢升米玉傑博士為研究發展組織副總經理；
- 核准擢升侯永清博士為設計暨技術平台組織副總經理；及
- 核准任命施振榮先生、彼得・邦菲（Peter Leahy Bonfield）爵士、湯馬斯・延吉布斯（Thomas J. Engibous）先生、鄒至莊先生與陳國慈女士為薪酬委員會委員。

五、民國一百年十一月七日及八日董事常會：
- 核准資本預算美金10億6,140萬元；及
- 核准研發資本預算及一百零一年度經常性資本預算共美金2億3,390萬元。

六、民國一百零一年二月十三日及十四日董事常會：
- 核准民國一百年度營業報告書及財務報表；
- 核准民國一百年度盈餘分派與現金股利、員工現金獎金及員工紅利議案；
- 核准資本預算美金13億9,550萬元；
- 核准研發資本預算美金2億3,960萬元；及
- 召集民國一百零一年度股東常會，會中並將改選包含五名獨立董事在內的共九名董事。

4. 營運概況

身為專業積體電路製造服務的創始者和領導者，台積公司的成就源自於提供客戶先進的製程技術、「超越摩爾定律」（More-than-Moore）的製程技術以及優異的生產效率。台積公司致力於提供客戶最高的整體價值，視客戶的成功為台積公司的成功。

民國九十八年五月，台積公司設立新事業組織，以開拓專業積體電路製造服務領域以外的相關市場機會。民國一百年八月，新事業組織正式獨立為台積固態照明與台積太陽能兩家子公司，持續推動固態照明及太陽能相關的二項新事業。

過去二十四年來，全球已有超過600家客戶透過台積公司生產應用於個人電腦與其週邊產品、資訊應用產品、有線與無線通訊系統產品、汽車與工業用設備以及包括數位影音光碟機、數位電視、遊戲機、數位相機等消費性電子與其他應用產品的晶片。

未來終端電子產品的日新月異，將促使客戶更加廣泛地採用台積公司創新的技術與服務，同時也更促進台積公司自身的技術發展，台積公司深信成功將屬於產業的領導者而非追隨者。

4.1 先進技術

民國一百年，台積公司持續擴大研發規模，進一步強化技術領先優勢，並新設一個研發製程中心（R&D Process Center）以加速製程進入量產製造。

全年研發預算約佔總營收之7.9%，此一研發投資規模不僅與眾多世界級一流半導體科技公司相當，甚至超越了許多公司的規模。由於研發預算增加，台積公司也同時擴增研發團隊人力，增幅超過13.3%。

有鑑於驅動互補金屬氧化物半導體（CMOS）製程微縮的摩爾定律能否繼續延伸，已面臨眾多技術面之困難，在擁有豐富半導體研發經驗的研發副總經理們的領導下，台積公司持續努力提升其研發組織的能力，相信將能克服眾多技術及未來的挑戰。民國一百年，台積公司是第一家28奈米製程技術進入量產的專業積體電路製造服務公司，並且已經開始出貨給客戶。透過迅速密集的努力，此一先進製程技術在民國一百年第四季貢獻總營收將近2%，預計民國一百零一年將會有更顯著的成長。

同時，台積公司亦更進一步加速先進元件技術的發展，除嵌入式記憶體與超低介電層銅導線技術的發展外，也特別在14奈米製程導入3D立體結構的鰭式場效電晶體（FinFET）先進製程技術。此外，台積公司於民國一百年持續領先專業積體電路製造服務領域，提供28奈米高介電層／金屬閘（HKMG）製程服務，成功開發20奈米先進製程技術，並領先研發14奈米先進元件的創新領域，再次證明了台積公司研發團隊的堅實能力。

台積公司亦致力於擴展與研發夥伴的合作以及與世界級研發機構的聯盟，例如：台積公司是位於比利時的知名半導體技術研發中心IMEC的核心會員，同時也與矽智財公司策略合作，促成先進製程之矽智財研究發展。此外，台積公司也加強與主要合作夥伴對設計和製程做最佳化的研究開發，並持續贊助國內外主要的大學從事奈米科技研究，以推動創新及先進技術。

上述研發上的努力與投入，讓台積公司屢屢能夠領先專業積體電路製造服務領域，提供客戶最新的量產製程技術與設計解決方案，以協助客戶在複雜且充滿挑戰的市場環境成功且快速地推出產品。

台積公司將持續和國際聯盟及光學微影設備供應商合作，確保能夠即時進行193奈米波長高數值孔隙（NA）掃描機技術、極紫外線（EUV）微影技術和多重平行電子束投影技術的開發，以支援14奈米和10奈米及更先進製程技術的製程研發工作。

4.2 卓越製造

超大晶圓廠（GIGAFAB™）

台積公司的十二吋超大晶圓廠是其製造策略的重要關鍵。台積公司目前擁有三座十二吋超大晶圓廠—晶圓十二廠、晶圓十四廠及晶圓十五廠。民國一百年，這三座超大晶圓廠的總產能已達到326萬1,000片十二吋晶圓，目前提供0.13微米、90奈米、65奈米、40奈米、28奈米全世代以及其半世代設計的生產，並保留部分產能作為研發用途，以支援20奈米、14奈米及更先進製程的技術發展。台積公司的整合製造管理平台除了能讓客戶得到相同的品質與可靠度的表現，還能享有更大的產能彈性、縮短良率學習曲線、量產時間，並減少昂貴的產品重新認證所需要的流程。

工程效能最佳化

台積公司利用先進機台控制（Advanced Equipment Control）與即時缺陷偵測分析（Fault Detection & Diagnosis）等最先進的資訊科技系統，並透過資訊整合、工作流程最佳化與自動化，來優化機台效能、改善機台效率、效能及工程能力。

台積公司並使用最先進分析方法，定義出與產品效能相關的機台與製程參數，並使用虛擬量測（Virtual Metrology）、整合良率分析管理的先進製程控制（Advanced Process Control）、即時缺陷偵測分類系統（Fault Detection Classification）、統計製程控制（Statistical Process Control）、晶圓測試（Circuit Probe）等方法，達到最優化的機台製程能力，符合產品效能。

在每一個製程步驟所建立的精準模型與控制，能驅動智慧模組化迴圈控制。這種製程控制方法，可以透過最先進的電腦整合製造方法派工，同時也能在高度複雜的半導體生產環境中，展現精準製造的實力。

精準製造

台積公司獨有的製造架構，是為擁有複雜產品組合的專業積體電路製造服務而所量身訂作。為了卓越製造的承諾，台積公司發展出最精細複雜的排程、即時派工與物料自動搬運系統，不斷改善並簡化生產流程，以期能在最短時間內用最有效的方式服務客戶。台積公司透過即時監控、分析與診斷機台生產力，能將生產的干擾降到最低，並獲得最佳的成本效益。

主要原物料暨供應鏈風險管理

民國一百年，台積公司資材供應鏈管理處、各廠區、風險管理處及品質系統管理處，持續透過定期召開之供應鏈風險管理會議，進行供應鏈風險管理與改善計劃。台積公司也與供應商合作提升品質、交期、風險管理的成效，並支持綠色採購、環境保護和工業安全。

4.3 客戶信任

客戶

台積公司的客戶遍布全球，產品種類眾多，在半導體產業的各個領域中表現傑出，無晶圓廠設計公司的客戶包括Altera、AMD、Broadcom、Marvell、NVIDIA、Qualcomm、聯發科技等；整合元件製造商的客戶有Analog Devices、Freescale、NXP、Texas Instruments等。

客戶服務

台積公司致力提供客戶最好的服務，並深信客戶服務是鞏固客戶滿意及忠誠度的關鍵，而客戶忠誠度則有助於穩固現有客戶、吸引新客戶，並強化客戶關係。透過一個全力以赴的客戶服務團隊作為協調溝通的窗口，台積公司矢志在設計支援、光罩、製造與後段封裝領域，提供客戶世界級、高品質與高效率的專業服務，創造最佳的客戶服務經驗，並贏得客戶信任與實現公司的長久獲利。

為了促進與客戶的互動及資訊的即時交流，台積公司以網際網路為基礎，提供了更積極主動的設計、工程及後勤合作的「EFOUNDRY®」整合服務系統，讓客戶可以一天24小時、一星期七天隨時掌握重要訊息，產生自訂報表。設計合作可提供客戶在每一設計階段準確及最新的設計資訊；工程合作可提供客戶晶片良率測試及可靠度相關的工程資訊；後勤合作可每天提供三次客戶晶片在工廠封裝測試及運送的後勤資訊。

客戶滿意度

台積公司定期舉辦年度客戶滿意度調查（Annual Customer Satisfaction Survey），以確保客戶的需求得到了解與妥善照應，並達成高滿意度的服務。此滿意度調查係由中立第三者顧問公司針對所有客戶透過網路或訪談來進行。

配合年度客戶滿意度調查，台積公司的客戶服務團隊每季亦在客戶來訪進行商業及技術會談時舉行商業評核會議（Quarterly-based Business Reviews），來更進一步瞭解客戶滿意度。透過問卷以及服務團隊與客戶的深入互動，台積公司更能密切貼近客戶需求以提升服務與合作品質。

台積公司針對客戶的意見提出改善計劃，並制訂有效的回報系統。台積公司不僅視客戶滿意評估與調查的結果為企業績效指標，也是未來成長的重要評估標準，並堅信客戶滿意度的提升最終會促成客戶忠誠度及業務的成長。

5. 企業社會責任

台積公司認為，「企業社會責任」包含許多面向，在「道德、商業水準、經濟、法治、平衡生活、關懷地球與下一代、公益」這幾方面的實踐和進步，都是身為一個企業公民應負的重要責任與使命。若能在這些方面，落實一己之力，樹立安定社會的力量，促使更多人起而效尤，社會就能更加美好。

我們堅信，所謂「企業社會責任」就是成為促使社會向上提升的力量，以實現「共創永續發展、公平正義、安居樂業的社會」的社會願景。以下台積公司實踐企業社會責任的十項原則，是我們持續為社會帶來正向發展的重要圭臬：

1. 堅持誠信正直，對股東、員工、及社會大眾皆同。
2. 遵守法律、依法行事、絕不違法。
3. 反對貪腐，拒絕裙帶關係；不賄賂、也不搞政商關係。
4. 重視公司治理，力求在股東、員工及所有利益關係人之間，達到利益均衡。
5. 不參與政治。
6. 提供優質工作機會，包括良好的待遇、具有高度挑戰的工作內容，及舒適安全的工作環境，以照顧員工的身心需求。
7. 因應氣候變遷，重視並持續落實環境保護措施。
8. 強調並積極獎勵創新，並充分管控創新改革的可能風險。
9. 積極投資固態照明以及太陽能等綠能產業，為環保節能盡一份心力。
10. 長期關懷社區，並持續贊助教育及文化活動。

在企業的「道德」方面，台積公司堅持誠信正直，反對貪腐，不賄賂、不搞政商關係。在企業的「商業水準」方面，除堅守上述倫理的要件之外，台積公司堅持良好的公司治理，營運透明，信守對所有利益關係人的承諾；同時積極鼓勵創新，帶動產業的發展，促進產業的繁榮。

在企業的「經濟」責任方面，由於台積公司對公司治理的堅持，加上良好的公司營運，積極鼓勵創新，提供待遇優良的優質工作機會，並予以股東優質的投資回饋，為社會創造價值。在「法治」責任方面，我們除了遵守法律、反對貪腐之外，更以最高的倫理和商業道德標準自我檢視和要求。

在「平衡生活」方面，台積公司提供員工優質的待遇與優良的工作環境，重視員工工作與生活的平衡；我們倡導減少不必要的會議、改善作業流程，主管以身作則，員工工作效率提高、工時減少，提供員工一個平衡健康的工作環境。

在「關懷地球與下一代」方面，為提供下一代良好健康的生活環境，做好環境保護、珍惜地球資源，產業界的努力尤其重要，台積公司更是責無旁貸。台積公司新建的廠房及辦公大樓均符合綠建築標準，為綠色的社會著想，使用符合環保要求的設備，室內亦有許多節能措施。

在關懷下一代的同時，台積公司亦善盡「公益」方面的努力，由員工自發性的組成台積電志工社，從事多樣公益活動，包括為大眾導覽、為學子導讀，並有節能志工將公司節能的專長分享給其他學校機構，除了有利社會，此志願性的服務亦能帶給員工生活的快樂與平衡；此外，公司亦成立有台積電文教基金會，積極投入公益，獎勵莘莘學子，贊助社區及文化活動。

台積公司持續在以上各個面向的企業社會責任上加倍努力，以成為促使社會向上提升的力量之一。在為所有利益關係人創造價值的同時，我們堅守對環境永續發展的承諾，矢志成為全球產業界的模範，樹立標竿。過去，經由全體同仁兢兢業業的奮鬥，台積公司在公司治理、營運、投資人關係、員工福利、環保績效等各方面，獲得多項肯定；展望未來，台積公司將更加深耕並落實上述企業社會責任的原則，為公司所有關係人開創多贏，為社會創造更美好的將來。

企業社會責任：讓社會更好

台積電	道德	商業水準	經濟	法治	關懷地球，為下一代著想	平衡生活，快樂	公益
誠信正直	V	V					
守法				V			
反對貪腐、不賄賂、不搞政商關係	V	V		V			
環保、氣候變遷、節能					V		
重視公司治理		V	V				
提供優質工作			V			V	
優質股東回饋			V				
推動員工生活平衡						V	
積極鼓勵創新		V	V				
提供優良工作環境						V	
志工社服務					V	V	V
文教基金會							V

5.1 環保、安全與衛生管理

台積公司在推動環保、安全與衛生活動方面，不但符合國內相關法令的規定，也與國際認同的標準接軌。在民國九十九年，台積公司的環保、安全與衛生政策做了重大更新並由董事長簽署，將「安全零事故、環境永續發展」成為世界級之環保、安全與衛生標竿企業訂為目標。為達此目標，台積公司的策略是「遵守法規承諾、促進安全健康、強化資源利用及污染預防、管控環安衛風險、深植環安衛文化、建構綠色供應鏈、善盡企業社會責任」。

台積公司於民國一百年連續十一年獲選列名道瓊永續指數之「世界指數」。

台積公司所有廠區均已取得環境管理系統（ISO 14001: 2004）及職業安全衛生管理系統（OHSAS 18001: 2007）認證。自民國九十八年，所有位於台灣的廠區均取得「台灣職業安全衛生管理系統」認證。

秉持著持續改善的精神，積極地在污染防治、能源及資源節約、廢棄物減量、安全衛生管理、火災爆炸預防及其他包含地震等危害防阻方面，提出並執行確實可行的改善方案，以降低整體的環保、安全與衛生風險。

民國九十五年，為因應歐盟電子電機設備中有害物質禁用指令（Restriction of Hazardous Substances, RoHS），以及客戶對於產品有害物質管理的要求，台積公司開始導入有害物質流程管理系統（QC 080000），並自民國九十六年完成所有廠區的認證。台積公司透過建立產品有害物質管理系統，持續確保產品符合國際法規及客戶要求，包括歐盟的有害物質限用指令（EU RoHS）、歐盟新化學品政策（EU REACH）、蒙特婁議定書之破壞臭氧層物質、電子產品無鹵素標準及全氟辛烷磺酸限制標準等。

台積公司為持續推動節約能源，於民國一百年導入「ISO 50001能源管理系統」。並且由晶圓十二廠第四期廠區資訊中心取得「ISO 50001能源管理系統」驗證，成為業界首先完成該驗證的高密度運算資訊中心。同時，台積公司亦將陸續推廣ISO 50001能源管理系統至各晶圓廠區。

台積公司承諾對供應商及承攬商在環保、安全與衛生議題上進行了解與溝通，鼓勵其增進環保、安全與衛生績效。有鑑於此，台積公司針對承攬商施工採行重點管理及自主管理。台積公司要求承接高風險工程的承攬商，必須完成施工人員的技能認證才得施作；並且須完成建構安衛管理系統（OHSAS 18001）才可進行競標，藉此加重承攬商自主管理的責任感，進而為整個業界提升承攬商的安全文化與技能素質。

台積公司與供應商合作以提升包括環保、安全與衛生之供應鏈永續性績效，例如碳足跡、水足跡的建立，以及衝突金屬的管理等。我們不僅針對供應商進行現場稽核，亦對其進行輔導，以提升其環保、安全與衛生的績效。

減少供應鏈碳足跡與水足跡為台積公司綠色供應鏈之要項。台積公司自民國九十八年開始，即要求供應商建立碳盤查程序，民國九十九年再帶領國內15家主要供應商參加由工業局主辦、工研院輔導之產品碳足跡建置計劃，完成供應商與台積公司產品的碳足跡。於民國一百年二月亦依據英國PAS2050產品碳足跡標準，通過了十二吋晶圓及封裝後積體電路產品第三者驗證機構之查驗，成為全國第一家帶領上下游供應商完成產品碳足跡之企業。

此外，台積公司亦著手了解供應鏈中潛在缺水風險和調查用水情形，並計劃與供應商合作建立水足跡及節水措施。台積公司持續進行供應商環保、安全與衛生管理計劃，並與涵蓋綠色環保、社會責任與風險管理三大要素的永續指標相互連結。其中，綠色環保指標包括環境管理系統、法規符合性、有害物質管理、衝突金屬調查、溫室氣體盤查、碳足跡、水足跡與其他環保活動等；社會責任指標包括勞工與道德準則，以及社區活動參與；風險管理指標則包括安全與衛生、火災、天然災害、資訊系統、運輸、供應鏈管理、防疫計劃及營運持續計劃等。台積公司並將永續指標應用至主要的供應商管理。民國一百年，台積公司舉辦第十一屆年度供應鏈論壇，藉以表達我們對供應商的支持與貢獻之謝意，同時亦表揚數家對環保傑出表現之設備供應商。

台積公司已建立全面環保、安全與衛生管理（TSM）系統，此系統為網路介面整合性之環保、安全與衛生管理系統，內容分為規劃－實施－檢查－行動（P-D-C-A）及資訊等五大類，包括風險評估、安全變更管理、施工管理、教育訓練、事故調查及環保、安全與衛生績效指標等二十多項系統。TSM系統為環保、安全與衛生績效指標管理之基石，同時提供各廠區間的比較以制定決策及提升營運績效。台積公司藉由此系統跨廠區之資訊，以達到降低風險、降低成本、提升環保、安全與衛生績效之目的。

5.2 台積電文教基金會

台積公司於民國八十七年成立「台積電文教基金會」，透過「人才培育」、「社區營造」、「藝文推廣」及「企業志工」四大方向，善盡企業社會責任。

民國一百年台積電文教基金會持續深耕教育文化，支持台北市立美術館成立「兒童藝術教育中心」；開啟「高中物理實驗學程」，同時邀請柏林愛樂來台、製播「莊子辛說」中國經典廣播節目。除教育文化上的努力，台積電文教基金會亦持續支持「台積電志工社」，號召公司同仁以實際行動關懷社區弱勢。

5.3 台積電志工社

善盡企業社會責任，向來是台積公司在專注於本業之外，對社會大眾的回饋與服務中，極為重要的一環。尤其，台積公司員工多屬高科技從業人員，具備高素質專業能力及訓練，他們的知識與熱情除了用於日常工作外，也投入社會參與，兼顧工作與生活。因此，台積電文教基金會一方面為服務貢獻與回饋社會，於「教育文化推廣」、「彌補弱勢資源」、「推動節能環保」、「落實社區關懷」善盡企業心力；另一方面也鼓勵員工多接觸社會、兼顧多元生活。自民國九十二年起，台積電文教基金會成立了台積電志工社，統籌規劃各項志工服務，並邀請台積電暨關係企業的員工及眷屬加入志工服務的行列，長期投入教育及文化推廣，將小愛化為大愛，點滴成河。

6. 堅實穩健的財務基礎

台灣積體電路製造股份有限公司

資產負債表

民國九十六年至民國一〇〇年十二月三十一日

（單位：新台幣仟元）

	一〇〇年 十二月三十一日	九十九年 十二月三十一日	九十八年 十二月三十一日	九十七年 十二月三十一日	九十六年 十二月三十一日
資產					
流動資產					
現金及約當現金	$ 85,262,521	$ 109,511,130	$ 117,043,543	$ 138,208,360	$ 72,422,102
公平價值變動列入損益之金融資產	14,925	-	181,743	42,460	42,083
備供出售金融資產	2,617,134	3,918,274	-	-	22,267,223
持有至到期日金融資產	701,136	4,796,589	9,944,843	5,881,999	11,526,946
應收關係人款項	24,777,534	25,733,974	22,541,773	11,728,204	26,701,648
應收票據及帳款	19,894,386	22,250,905	19,884,520	11,441,176	17,911,328
備抵呆帳	(485,120)	(488,000)	(431,000)	(436,746)	(688,972)
備抵退貨及折讓	(4,887,879)	(7,341,444)	(8,583,632)	(5,868,582)	(3,856,685)
其他應收關係人款項	188,028	1,302,281	246,003	489,742	525,308
其他金融資產	122,010	418,206	1,104,072	711,755	331,698
存貨	22,853,397	25,646,348	18,830,216	12,807,936	20,987,142
遞延所得稅資產	5,779,544	5,133,775	4,063,410	3,650,700	5,268,000
預付費用及其他流動資產	1,725,736	1,352,244	1,006,046	1,192,475	861,465
流動資產合計	158,563,352	192,234,282	185,831,537	179,849,479	174,299,286
長期投資					
採權益法之長期股權投資	128,200,718	114,977,174	104,660,098	109,871,178	113,048,081
備供出售金融資產	-	1,033,049	1,046,672	2,032,658	1,397,186
持有至到期日金融資產	702,291	1,405,698	12,219,055	11,761,325	8,697,726
以成本衡量之金融資產	497,835	497,835	501,988	519,502	748,160
長期投資合計	129,400,844	117,913,756	118,427,813	124,184,663	123,891,153
固定資產					
成本					
建築物	149,495,478	128,646,942	124,522,047	114,014,588	101,907,892
機器設備	984,978,666	852,733,592	713,426,126	635,008,261	589,131,625
辦公設備	13,824,434	11,730,537	10,781,099	9,748,869	9,167,107
	1,148,298,578	993,111,071	848,729,272	758,771,718	700,206,624
累積折舊	(804,740,797)	(706,605,445)	(627,764,323)	(557,247,254)	(486,725,019)
預付款項及未完工程	110,815,752	80,348,673	33,786,577	17,758,038	21,082,953
固定資產淨額	454,373,533	366,854,299	254,751,526	219,282,502	234,564,558

	一〇〇年 十二月三十一日	九十九年 十二月三十一日	九十八年 十二月三十一日	九十七年 十二月三十一日	九十六年 十二月三十一日
無形資產					
商譽	1,567,756	1,567,756	1,567,756	1,567,756	1,567,756
遞延借項－淨額	4,719,244	5,456,427	5,891,685	6,401,461	7,172,413
無形資產合計	6,287,000	7,024,183	7,459,441	7,969,217	8,740,169
其他資產					
遞延所得稅資產	7,221,824	7,154,266	7,763,643	6,497,972	7,241,933
存出保證金	4,491,735	8,638,749	2,698,116	2,719,737	2,741,538
其他	1,069,586	1,420,131	494,546	55,677	293,986
其他資產合計	12,783,145	17,213,146	10,956,305	9,273,386	10,277,457
資產總計	$ 761,407,874	$ 701,239,666	$ 577,426,622	$ 540,559,247	$ 551,772,623
負債及股東權益					
流動負債					
短期借款	$ 25,926,528	$ 30,908,637	$ -	$ -	$ -
公平價值變動列入損益之金融負債	-	7,834	-	83,618	247,646
應付帳款	9,522,688	10,559,283	9,678,849	4,314,265	9,485,818
應付關係人款項	2,992,582	2,574,450	2,039,342	1,202,350	2,999,630
應付所得稅	10,647,797	7,108,869	8,761,120	9,222,811	10,977,963
應付薪資及獎金	4,840,794	5,287,751	8,677,299	1,601,897	1,632,177
應付員工紅利及董事酬勞	9,055,704	10,959,469	6,771,338	15,148,057	-
應付工程及設備款	33,811,970	41,992,198	28,756,884	7,574,891	5,389,740
應付費用及其他流動負債	8,216,367	8,623,769	7,886,263	5,951,578	13,067,836
一年內到期之應付公司債	4,500,000	-	-	8,000,000	-
流動負債合計	109,514,430	118,022,260	72,571,095	53,099,467	43,800,810
長期負債					
應付公司債	18,000,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	12,500,000
其他長期應付款	-	-	416,390	931,252	1,501,462
長期負債合計	18,000,000	4,500,000	4,916,390	5,431,252	14,001,462
其他負債					
應計退休金負債	3,860,898	3,824,601	3,807,176	3,710,009	3,657,679
存入保證金	439,032	747,887	1,001,376	1,479,152	2,240,677
遞延貸項	-	-	47,873	462,256	980,593
其他負債合計	4,299,930	4,572,488	4,856,425	5,651,417	6,878,949
負債合計	131,814,360	127,094,748	82,343,910	64,182,136	64,681,221
股東權益					
股本－每股面額10元					
普通股發行	259,162,226	259,100,787	259,027,066	256,254,373	264,271,037
資本公積	55,846,357	55,698,434	55,486,010	49,875,255	53,732,682
保留盈餘					
法定盈餘公積	102,399,995	86,239,494	77,317,710	67,324,393	56,406,684
特別盈餘公積	6,433,874	1,313,047	-	391,857	629,550
未分配盈餘	213,357,286	178,227,030	104,564,972	102,337,417	161,828,337
保留盈餘合計	322,191,155	265,779,571	181,882,682	170,053,667	218,864,571
股東權益其他項目					
累積換算調整數	(6,433,369)	(6,543,163)	(1,766,667)	481,158	(1,072,853)
金融商品未實現（損）益	(1,172,855)	109,289	453,621	(287,342)	680,997
庫藏股票	-	-	-	-	(49,385,032)
股東權益其他項目合計	(7,606,224)	(6,433,874)	(1,313,046)	193,816	(49,776,888)
股東權益合計	629,593,514	574,144,918	495,082,712	476,377,111	487,091,402
負債及股東權益總計	$ 761,407,874	$ 701,239,666	$ 577,426,622	$ 540,559,247	$ 551,772,623

台灣積體電路製造股份有限公司

損益表

民國九十六年至民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日

（單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元）

	一〇〇年度	九十九年度	九十八年度	九十七年度	九十六年度（註一）
銷貨收入總額	$ 421,472,087	$ 418,666,448	$ 299,471,214	$ 330,228,027	$ 319,167,299
銷貨退回及折讓	3,226,594	11,703,136	13,728,346	8,460,944	5,519,655
銷貨收入淨額	418,245,493	406,963,312	285,742,868	321,767,083	313,647,644
銷貨成本	233,083,068	209,921,268	159,106,619	183,589,540	176,223,224
銷貨毛利	185,162,425	197,042,044	126,636,249	138,177,543	137,424,420
聯屬公司間已（未）實現銷貨毛利	398,440	(52,742)	(160,279)	72	(265,106)
已實現銷貨毛利	185,560,865	196,989,302	126,475,970	138,177,615	137,159,314
營業費用					
研究發展費用	31,594,034	27,623,299	19,688,032	19,737,038	15,913,834
管理費用	12,715,339	11,681,756	10,238,131	9,895,617	7,660,776
行銷費用	2,345,729	2,837,739	2,027,454	2,254,728	1,332,657
合計	46,655,102	42,142,794	31,953,617	31,887,383	24,907,267
營業利益	138,905,763	154,846,508	94,522,353	106,290,232	112,252,047
營業外收入及利益					
按權益法認列之投資淨益	3,778,083	7,111,443	-	72,568	5,468,230
和解賠償收入	947,340	6,939,764	1,464,915	951,180	985,114
金融商品評價淨益	801,195	312,862	587,151	-	-
利息收入	697,196	764,027	1,117,374	2,728,892	2,634,636
技術服務收入	408,153	446,746	375,118	619,237	712,162
處分固定資產及其他資產利益	103,017	77,452	196,856	298,772	305,201
租金收入	67,576	145,006	138,744	164,321	368,748
處分金融資產淨益	125,353	-	53,364	452,159	271,094
兌換淨益	-	-	-	1,113,406	71,128
其他收入	359,133	110,668	187,987	325,090	289,479
合計	7,287,046	15,907,968	4,121,509	6,725,625	11,105,792
營業外費用及損失					
兌換淨損	673,085	58,737	630,455	-	-
利息費用	445,887	214,641	142,026	355,056	584,736
處分固定資產損失	202,901	838,750	58,242	3	4,814
災害損失	-	190,992	-	-	-
按權益法認列之投資淨損	-	-	2,695,720	-	-
金融商品評價淨損	-	-	-	1,230,966	924,316
金融資產減損損失	-	-	-	247,488	-
閒置資產減損損失	-	-	-	210,477	-
訴訟損失	-	-	-	99,126	1,008,635
其他損失	163,092	161,152	136,397	113,923	83,932
合計	1,484,965	1,464,272	3,662,840	2,257,039	2,606,433
稅前利益	144,707,844	169,290,204	94,981,022	110,758,818	120,751,406
所得稅費用	10,506,565	7,685,195	5,763,186	10,825,650	11,574,313
本年度淨利	$ 134,201,279	$ 161,605,009	$ 89,217,836	$ 99,933,168	$ 109,177,093
每股盈餘（註二）					
基本每股盈餘	$ 5.18	$ 6.24	$ 3.45	$ 3.84	$ 4.04
稀釋每股盈餘	$ 5.18	$ 6.23	$ 3.44	$ 3.81	$ 4.04

註一：若干科目經重新分類，俾配合九十七年度財務報表之表達。

註二：按盈餘及資本公積轉增資比率（九十六年至九十七年盈餘年度）及員工紅利配股比率（截至九十六年盈餘年度）追溯調整後之每股盈餘。

台灣積體電路製造股份有限公司

現金流量表

民國九十六年至民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日

（單位：新台幣仟元）

	一〇〇年度	九十九年度	九十八年度	九十七年度	九十六年度
營業活動之現金流量					
本年度淨利	$ 134,201,279	$ 161,605,009	$ 89,217,836	$ 99,933,168	$ 109,177,093
折舊及攤銷	102,925,423	83,366,121	74,327,868	74,569,562	72,820,579
聯屬公司間未（已）實現銷貨毛利	(398,440)	52,742	160,279	(72)	265,106
金融資產折溢價攤銷數	9,860	18,611	6,322	(97,381)	(117,159)
金融資產減損損失	-	-	-	247,488	-
處分備供出售金融資產淨益	(35,151)	-	(37,370)	(443,404)	(271,094)
持有至到期日金融資產被贖回利益	-	-	(16,091)	-	-
處分以成本衡量之金融資產淨損（益）	-	1,263	97	(8,755)	-
按權益法認列之投資淨損（益）	(3,778,083)	(7,111,443)	2,695,720	(72,568)	(5,468,230)
獲配採權益法被投資公司之現金股利	2,941,548	422,490	1,402,592	1,804,351	677,147
處分固定資產及其他資產淨損（益）	99,884	761,298	(138,613)	(298,769)	(300,387)
獲配股票作價賠償收入	-	(4,434,364)	-	-	-
提列閒置資產損失	-	-	-	210,477	-
遞延所得稅	(493,026)	(373,253)	(1,678,381)	2,361,261	1,083,194
營業資產及負債之淨變動					
公平價值變動列入損益之金融資產及負債	(22,759)	189,577	(222,901)	(164,405)	239,413
應收關係人款項	956,440	(3,192,201)	(10,813,569)	14,973,444	(9,832,139)
應收票據及帳款	2,356,519	(2,366,385)	(8,443,344)	6,470,152	(1,633,164)
備抵呆帳	(2,880)	57,000	(5,746)	(252,226)	(1,959)
備抵退貨及折讓	(2,453,565)	(1,242,188)	2,715,050	2,011,897	1,105,620
其他應收關係人款項	(38,049)	85,830	235,470	43,835	(76,042)
其他金融資產	138,196	904,157	(392,317)	(380,057)	321,762
存貨	2,775,646	(6,816,132)	(6,022,280)	8,179,206	(1,834,928)
預付費用及其他流動資產	(382,852)	(445,797)	290,470	(330,664)	359,734
應付帳款	(1,805,422)	624,608	4,925,758	(5,171,553)	3,342,139
應付關係人款項	418,132	535,108	836,992	(1,797,280)	(327,286)
應付所得稅	3,538,928	(1,652,251)	(461,691)	(1,766,153)	3,127,545
應付薪資及獎金	(426,797)	(3,389,548)	7,075,402	(30,280)	96,793
應付員工紅利及董事酬勞	(1,903,765)	4,188,131	(881,731)	15,148,057	-
應付費用及其他流動負債	16,750	265,241	1,259,544	(3,112,220)	1,162,945
應計退休金負債	96,880	17,425	97,167	52,330	127,563
遞延貸項	-	(47,873)	(230,487)	(129,494)	72,747
營業活動之淨現金流入	238,734,696	222,023,176	155,902,046	211,949,947	174,116,992
投資活動之現金流量					
分割事業現金支付數	(1,270,340)	-	-	-	-
購置固定資產	(202,757,541)	(182,335,032)	(86,970,843)	(56,766,192)	(81,303,047)
購買備供出售金融資產	-	-	-	(23,697,000)	(9,547,253)
購買持有至到期日金融資產	-	-	(10,803,805)	(12,371,965)	-
採權益法之長期股權投資增加	(7,390,883)	(8,262,519)	(320,443)	(494,765)	(7,358,685)
購買以成本衡量之金融資產	-	(480)	(1,411)	(20,681)	(36,333)
合併子公司取得現金數	-	-	-	270,650	-
處分備供出售金融資產價款	1,035,151	-	1,037,370	45,584,934	18,844,520
持有至到期日金融資產領回	4,789,000	15,943,000	6,293,000	15,004,000	17,325,120
處分以成本衡量之金融資產價款	-	3,370	18,828	10,606	-
被投資公司減資退回股款	320,013	-	27,753	2,465,293	433,551
處分固定資產及其他資產價款	4,650,078	387,735	71,850	2,042,899	54,509
遞延借項增加	(1,658,296)	(1,538,301)	(1,347,228)	(3,199,813)	(2,685,610)
存出保證金減少（增加）	4,147,014	(5,940,633)	21,621	21,801	(1,435,304)
其他資產增加	27,600	(1,004,581)	-	-	-
其他	-	-	-	-	(232,575)
投資活動之淨現金流出	(198,108,204)	(182,747,441)	(91,973,308)	(31,150,233)	(65,941,107)

	一〇〇年度	九十九年度	九十八年度	九十七年度	九十六年度
融資活動之現金流量					
短期借款增加（減少）	$ (4,982,109)	$ 30,908,637	$ -	$ -	$ -
發行公司債	18,000,000	-	-	-	-
償還公司債	-	-	(8,000,000)	-	(7,000,000)
存入保證金減少	(308,855)	(253,489)	(477,776)	(761,525)	(1,569,284)
現金股利	(77,730,236)	(77,708,120)	(76,876,312)	(76,881,311)	(77,489,064)
員工現金紅利	-	-	-	(3,939,883)	(4,572,798)
董事酬勞	-	-	-	(176,890)	(285,800)
買回庫藏股票	(71,598)	-	-	(33,480,997)	(45,413,373)
員工行使認股權發行新股	217,697	244,824	260,533	227,150	436,827
融資活動之淨現金流出	(64,875,101)	(46,808,148)	(85,093,555)	(115,013,456)	(135,893,492)
現金及約當現金淨增加（減少）數	(24,248,609)	(7,532,413)	(21,164,817)	65,786,258	(27,717,607)
年初現金及約當現金餘額	109,511,130	117,043,543	138,208,360	72,422,102	100,139,709
年底現金及約當現金餘額	$ 85,262,521	$ 109,511,130	$ 117,043,543	$ 138,208,360	$ 72,422,102
現金流量資訊之補充揭露					
支付利息	$ 369,085	$ 200,892	$ 351,803	$ 355,056	$ 661,200
支付所得稅	$ 7,454,386	$ 9,640,396	$ 7,791,196	$ 10,282,464	$ 7,330,401
同時影響現金及非現金項目之投資及融資活動					
購置固定資產價款	$ 195,932,728	$ 195,950,918	$ 108,592,471	$ 58,951,343	$ 76,023,264
應付工程及設備款減少（增加）	6,827,106	(13,491,140)	(21,620,819)	(2,185,151)	5,279,783
換出資產抵減價款	(2,293)	(124,746)	(809)	-	-
支付現金金額	$ 202,757,541	$ 182,335,032	$ 86,970,843	$ 56,766,192	$ 81,303,047
處分固定資產及其他資產價款	$ 3,370,165	$ 1,872,880	$ 64,390	$ 2,051,168	$ 54,509
其他應收關係人款項減少（增加）	1,124,206	(1,142,108)	8,269	(8,269)	-
其他金融資產款項減少（增加）	158,000	(218,291)	-	-	-
換出資產抵減價款	(2,293)	(124,746)	(809)	-	-
取得現金金額	$ 4,650,078	$ 387,735	$ 71,850	$ 2,042,899	$ 54,509
買回庫藏股票	$ 71,598	$ -	$ -	$ 30,427,413	$ 48,466,957
應付費用及其他流動負債減少（增加）	-	-	-	3,053,584	(3,053,584)
支付現金金額	$ 71,598	$ -	$ -	$ 33,480,997	$ 45,413,373
不影響現金流量之融資活動					
一年內到期之應付公司債	$ 4,500,000	$ -	$ -	$ 8,000,000	$ -
一年內到期之其他長期應付款（帳列應付費用及其他流動負債）	$ -	$ 718,637	$ 769,144	$ 1,026,421	$ 3,673,182

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國九十六年至民國一〇〇年十二月三十一日

（單位：新台幣仟元）

	一〇〇年十二月三十一日	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日	九十七年十二月三十一日	九十六年十二月三十一日
資產					
流動資產					
現金及約當現金	$ 143,472,277	$ 147,886,955	$ 171,276,341	$ 194,613,752	$ 94,986,488
公平價值變動列入損益之金融資產	15,360	6,886	186,081	55,730	1,632,387
備供出售金融資產	3,308,770	28,883,728	14,389,946	10,898,715	66,688,368
持有至到期日金融資產	3,825,680	4,796,589	9,944,843	5,881,999	11,526,946
應收關係人款項	185,764	2,722	12,524	407	10,885
應收票據及帳款	46,321,240	51,029,885	44,637,642	25,023,321	47,204,126
備抵呆帳	(490,952)	(504,029)	(543,325)	(455,751)	(701,807)
備抵退貨及折讓	(5,068,263)	(7,546,264)	(8,724,481)	(6,071,026)	(4,089,035)
其他應收關係人款項	122,292	124,586	121,292	99,918	243,620
其他金融資產	617,142	1,021,552	1,849,987	1,911,699	1,515,527
存貨	24,840,582	28,405,984	20,913,751	14,876,645	23,862,260
遞延所得稅資產	5,936,490	5,373,076	4,370,309	3,969,330	5,572,334
預付費用及其他流動資產	2,174,014	2,037,647	1,368,838	1,813,692	1,370,230
流動資產合計	225,260,396	261,519,317	259,803,748	252,618,431	249,822,329
長期投資					
採權益法之長期股權投資	24,900,332	25,815,385	17,871,208	18,907,158	22,517,289
備供出售金融資產	-	1,033,049	1,358,049	2,032,658	1,400,691
持有至到期日金融資產	5,243,167	8,502,887	15,553,242	15,426,252	8,697,726
以成本衡量之金融資產	4,315,005	4,424,207	3,063,004	3,615,447	3,845,619
長期投資合計	34,458,504	39,775,528	37,845,503	39,981,515	36,461,325
固定資產					
成本					
土地及土地改良	1,541,128	891,197	934,090	953,857	942,197
建築物	172,872,550	145,966,024	142,294,558	132,249,996	118,640,027
機器設備	1,057,588,736	913,155,252	775,653,489	697,498,743	646,419,427
辦公設備	16,969,266	14,856,582	13,667,747	12,430,800	11,829,640
租賃資產	791,480	701,552	714,424	722,339	652,296
	1,249,763,160	1,075,570,607	933,264,308	843,855,735	778,483,587
累積折舊	(876,252,220)	(773,278,157)	(693,743,886)	(618,816,267)	(540,099,567)
預付款項及未完工程	116,863,976	86,151,573	34,154,365	18,605,882	21,868,167
固定資產淨額	490,374,916	388,444,023	273,674,787	243,645,350	260,252,187
無形資產					
商譽	5,693,999	5,704,897	5,931,318	6,044,392	5,987,582
遞延借項－淨額	5,167,564	6,027,085	6,458,554	7,125,828	7,923,601
無形資產合計	10,861,563	11,731,982	12,389,872	13,170,220	13,911,183
其他資產					
遞延所得稅資產	7,436,717	7,362,784	7,988,303	6,636,873	7,313,283
存出保證金	4,518,863	8,677,970	2,733,143	2,767,199	2,777,769
其他	1,353,983	1,417,300	260,864	97,001	327,150
其他資產合計	13,309,563	17,458,054	10,982,310	9,501,073	10,418,202
資產總計	$ 774,264,942	$ 718,928,904	$ 594,696,220	$ 558,916,589	$ 570,865,226

	一〇〇年十二月三十一日	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日	九十七年十二月三十一日	九十六年十二月三十一日
負債及股東權益					
流動負債					
短期借款	$ 25,926,528	$ 31,213,944	$ -	$ -	$ -
公平價值變動列入損益之金融負債	13,742	19,002	25	85,187	249,313
避險之衍生性金融負債	232	814	-	-	-
應付票據及帳款	10,530,487	12,104,173	10,905,884	5,553,151	11,574,882
應付關係人款項	1,328,521	867,085	783,007	489,857	1,503,376
應付所得稅	10,656,124	7,184,697	8,800,249	9,331,825	11,126,128
應付薪資及獎金	6,148,499	6,424,064	9,317,035	2,215,780	2,233,450
應付員工紅利及董監酬勞	9,081,293	11,096,147	6,818,343	15,369,730	-
應付工程及設備款	35,540,526	43,259,857	28,924,265	7,998,773	6,256,732
應付費用及其他流動負債	13,218,235	10,779,923	12,635,182	7,540,055	15,481,313
一年內到期之應付公司債及長期銀行借款	4,562,500	241,407	949,298	8,222,398	280,813
流動負債合計	117,006,687	123,191,113	79,133,288	56,806,756	48,706,007
長期負債					
應付公司債	18,000,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	12,500,000
長期銀行借款	1,587,500	301,561	578,560	1,420,476	1,722,196
其他長期應付款	-	6,554,208	5,602,420	9,548,226	9,409,978
應付租賃款	870,993	694,986	707,499	722,339	652,296
長期負債合計	20,458,493	12,050,755	11,388,479	16,191,041	24,284,470
其他負債					
應計退休金負債	3,908,508	3,812,351	3,797,032	3,701,584	3,665,522
存入保證金	443,983	789,098	1,006,023	1,484,495	2,243,009
遞延貸項	26,533	126,539	185,689	316,537	1,236,873
其他	377,187	254,643	137,161	43,709	43,774
其他負債合計	4,756,211	4,982,631	5,125,905	5,546,325	7,189,178
負債合計	142,221,391	140,224,499	95,647,672	78,544,122	80,179,655
母公司股東權益					
股本－每股面額10元					
普通股發行	259,162,226	259,100,787	259,027,066	256,254,373	264,271,037
資本公積	55,846,357	55,698,434	55,486,010	49,875,255	53,732,682
保留盈餘					
法定盈餘公積	102,399,995	86,239,494	77,317,710	67,324,393	56,406,684
特別盈餘公積	6,433,874	1,313,047	-	391,857	629,550
未分配盈餘	213,357,286	178,227,030	104,564,972	102,337,417	161,828,337
保留盈餘合計	322,191,155	265,779,571	181,882,682	170,053,667	218,864,571
股東權益其他項目					
累積換算調整數	(6,433,369)	(6,543,163)	(1,766,667)	481,158	(1,072,853)
金融商品未實現（損）益	(1,172,855)	109,289	453,621	(287,342)	680,997
庫藏股票	-	-	-	-	(49,385,032)
股東權益其他項目合計	(7,606,224)	(6,433,874)	(1,313,046)	193,816	(49,776,888)
母公司股東權益合計	629,593,514	574,144,918	495,082,712	476,377,111	487,091,402
少數股權	2,450,037	4,559,487	3,965,836	3,995,356	3,594,169
股東權益合計	632,043,551	578,704,405	499,048,548	480,372,467	490,685,571
負債及股東權益總計	$ 774,264,942	$ 718,928,904	$ 594,696,220	$ 558,916,589	$ 570,865,226

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併損益表

民國九十六年至民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日

（單位：新台幣仟元,惟每股盈餘為元）

	一〇〇年度	九十九年度	九十八年度	九十七年度	九十六年度（註一）
銷貨收入總額	$ 430,490,500	$ 431,630,858	$ 309,655,614	$ 341,983,355	$ 328,336,172
銷貨退回及折讓	3,409,855	12,092,947	13,913,375	8,825,695	5,705,576
銷貨收入淨額	427,080,645	419,537,911	295,742,239	333,157,660	322,630,596
銷貨成本	232,937,388	212,484,320	166,413,628	191,408,099	180,280,385
銷貨毛利	194,143,257	207,053,591	129,328,611	141,749,561	142,350,211
關聯企業間未實現銷貨毛利	(74,029)	-	-	-	-
已實現銷貨毛利	194,069,228	207,053,591	129,328,611	141,749,561	142,350,211
營業費用					
研究發展費用	33,829,880	29,706,662	21,593,398	21,480,937	17,946,322
管理費用	14,164,114	12,803,997	11,285,478	11,096,599	8,963,836
行銷費用	4,517,816	5,367,597	4,487,849	4,736,657	3,718,146
合計	52,511,810	47,878,256	37,366,725	37,314,193	30,628,304
營業利益	141,557,418	159,175,335	91,961,886	104,435,368	111,721,907
營業外收入及利益					
利息收入	1,479,514	1,665,193	2,600,925	5,373,823	5,651,700
和解賠償收入	947,340	6,939,764	1,464,915	951,180	985,114
按權益法認列之投資淨益	897,611	2,298,159	45,994	701,533	2,507,869
金融商品評價淨益	507,432	320,730	594,660	-	63,017
技術服務收入	407,089	450,503	367,013	1,181,966	590,391
處分金融商品淨益	233,214	736,843	15,999	721,050	874,670
處分固定資產及其他資產利益	203,959	216,199	113,963	100,874	91,210
租金收入	78,076	156,939	153,919	166,317	378,643
兌換淨益	-	-	-	1,227,653	80,922
補助款收入	-	-	-	8,029	364,321
其他收入	604,292	351,742	296,160	389,024	345,946
合計	5,358,527	13,136,072	5,653,548	10,821,449	11,933,803
營業外費用及損失					
利息費用	$ 626,725	$ 425,356	$ 391,479	$ 614,988	$ 842,242
金融資產減損損失	265,515	159,798	913,230	1,560,055	54,208
處分固定資產損失	200,673	849,254	68,486	589	6,190
兌換淨損	185,555	99,130	626,971	-	-
閒置資產減損損失	98,009	319	-	210,477	-
災害損失	-	190,992	-	-	-
金融商品評價淨損	-	-	-	1,081,019	-
訴訟損失	-	-	-	99,126	1,008,635
其他損失	391,791	316,163	152,621	218,317	102,409
合計	1,768,268	2,041,012	2,152,787	3,784,571	2,013,684
稅前利益	145,147,677	170,270,395	95,462,647	111,472,246	121,642,026
所得稅費用	10,694,417	7,988,465	5,996,424	10,949,009	11,709,626
合併總淨利	$ 134,453,260	$ 162,281,930	$ 89,466,223	$ 100,523,237	$ 109,932,400
歸屬予：					
母公司股東	$ 134,201,279	$ 161,605,009	$ 89,217,836	$ 99,933,168	$ 109,177,093
少數股權	251,981	676,921	248,387	590,069	755,307
	$ 134,453,260	$ 162,281,930	$ 89,466,223	$ 100,523,237	$ 109,932,400
每股盈餘（註二）					
基本每股盈餘	$ 5.18	$ 6.24	$ 3.45	$ 3.84	$ 4.04
稀釋每股盈餘	$ 5.18	$ 6.23	$ 3.44	$ 3.81	$ 4.04

註一：若干科目經重新分類，俾配合九十七年度財務報表之表達

註二：按盈餘及資本公積轉增資比率（九十六年至九十七年盈餘年度）及員工紅利配股比率（九十六年盈餘年度）追溯調整後之每股盈餘

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國九十六年至民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日

（單位：新台幣仟元）

	一〇〇年度	九十九年度	九十八年度	九十七年度	九十六年度
營業活動之現金流量：					
歸屬予母公司股東之淨利	$ 134,201,279	$ 161,605,009	$ 89,217,836	$ 99,933,168	$ 109,177,093
歸屬予少數股權之淨利	251,981	676,921	248,387	590,069	755,307
折舊及攤銷	107,681,521	87,810,103	80,814,748	81,512,191	80,005,395
關聯企業間未實現銷貨毛利	74,029	-	-	-	-
金融資產折溢價攤銷數	24,711	34,142	21,483	(93,393)	(117,159)
金融資產減損損失	265,515	159,798	913,230	1,560,055	54,208
處分備供出售金融資產淨損（益）	(212,442)	(603,368)	20,337	(637,219)	(610,167)
持有至到期日金融資產被贖回利益	-	-	(16,091)	-	-
處分以成本衡量之金融資產淨益	(20,772)	(133,475)	(20,245)	(83,831)	(264,503)
按權益法認列之投資淨益	(897,611)	(2,298,159)	(45,994)	(701,533)	(2,507,869)
獲配採權益法被投資公司之現金股利	2,848,141	320,002	1,239,490	1,661,134	625,130
處分固定資產及其他資產淨損（益）	(3,286)	633,230	(45,475)	(100,285)	(85,020)
獲配股票作價賠償收入	(158,779)	(4,434,364)	-	-	-
提列閒置資產減損損失	98,009	319	-	210,477	-
遞延所得稅	(491,122)	(377,248)	(1,752,409)	2,279,414	943,797
營業資產及負債之淨變動：					
公平價值變動列入損益之金融資產及負債	(13,734)	198,172	(215,513)	1,412,531	(187,084)
應收關係人款項	123,265	9,802	(12,117)	10,478	629,467
應收票據及帳款	3,627,110	(6,392,243)	(19,614,321)	22,180,805	(12,134,176)
備抵呆帳	(12,844)	(39,296)	87,574	(246,056)	(48,126)
備抵退貨及折讓	(2,478,001)	(1,178,217)	2,653,455	1,981,991	1,205,277
其他應收關係人款項	2,294	(3,294)	(21,374)	143,702	13,243
其他金融資產	376,342	740,959	7,834	(425,937)	842,136
存貨	2,611,297	(7,492,233)	(6,037,106)	8,985,615	(2,226,106)
預付費用及其他流動資產	(403,762)	(752,408)	585,430	(443,462)	290,434
應付票據及帳款	(1,968,820)	933,894	4,916,885	(6,021,731)	3,218,255
應付關係人款項	462,578	84,078	293,150	(1,013,519)	(375,731)
應付所得稅	3,490,268	(1,615,552)	(531,576)	(1,794,303)	3,179,655
應付薪資及獎金	(275,565)	(2,892,971)	7,101,255	(17,670)	116,405
應付員工紅利及董監酬勞	(1,925,594)	4,277,804	(1,056,399)	15,369,730	-
應付費用及其他流動負債	304,582	248,192	1,356,269	(3,936,757)	797,467
應計退休金負債	98,915	15,319	95,448	36,062	125,462
遞延貸項	(92,454)	(59,150)	(237,726)	(858,161)	343,878
營業活動之淨現金流入	247,587,051	229,475,766	159,966,465	221,493,565	183,766,668
投資活動之現金流量：					
購置固定資產	(213,962,521)	(186,944,203)	(87,784,906)	(59,222,654)	(84,000,985)
購買備供出售金融資產	(35,088,394)	(48,340,334)	(38,800,577)	(85,273,867)	(87,550,197)
購買持有至到期日金融資產	(584,280)	(4,101,501)	(12,224,353)	(16,523,275)	-
按權益法之長期股權投資增加	-	(6,242,350)	(42,947)	(55,871)	(5,803,826)
購買以成本衡量之金融資產	(403,908)	(1,812,928)	(321,195)	(463,211)	(911,323)
處分備供出售金融資產價款	59,305,023	37,816,288	36,039,978	138,515,023	94,908,666
持有至到期日金融資產領回	4,789,000	15,943,000	7,944,800	15,634,620	17,325,120
處分以成本衡量之金融資產價款	226,226	242,335	131,075	199,424	410,465
處分固定資產及其他資產價款	698,055	115,524	24,241	194,940	60,535
被投資公司減資退回股款	-	-	-	2,345,867	-
遞延借項增加	(1,715,892)	(1,801,728)	(1,469,831)	(3,395,287)	(3,059,155)
存出保證金減少（增加）	4,149,543	(5,944,827)	34,056	10,570	(1,434,895)
取得子公司淨支付現金數	-	-	-	-	(404,445)
其他資產減少（增加）	63,723	(1,015,458)	1,176	(8,163)	(228,747)
投資活動之淨現金流出	(182,523,425)	(202,086,182)	(96,468,483)	(8,041,884)	(70,688,787)
融資活動之現金流量：					
短期借款增加（減少）	(5,287,416)	31,213,944	-	-	(89,720)
舉借長期借款	2,250,000	-	286,574	98,400	653,000
償還長期借款	(1,142,968)	(967,034)	(378,673)	(468,313)	(196,173)
發行公司債	18,000,000	-	-	-	-
償還公司債	-	-	(8,000,000)	-	(7,000,000)
其他長期應付款減少	(3,633,052)	(1,107,333)	-	-	-
存入保證金減少	(342,242)	(232,925)	(478,472)	(758,514)	(1,574,131)

	一〇〇年度	九十九年度	九十八年度	九十七年度	九十六年度
現金股利	$ (77,730,236)	$ (77,708,120)	$ (76,876,312)	$ (76,779,032)	$ (77,387,302)
員工現金紅利	-	-	-	(3,939,883)	(4,572,798)
董監事酬勞	-	-	-	(176,890)	(285,800)
受領贈與	-	49,021	-	-	-
員工行使認股權發行新股	217,697	244,824	260,533	227,150	436,827
買回庫藏股票	(71,598)	-	-	(33,480,997)	(45,413,373)
少數股權增加（減少）	(118,226)	(130,083)	(284,774)	(114,742)	19,004
融資活動之淨現金流出	(67,858,041)	(48,637,706)	(85,471,124)	(115,392,821)	(135,410,466)
現金及約當現金淨增加（減少）	(2,794,415)	(21,248,122)	(21,973,142)	98,058,860	(22,332,585)
匯率影響數	(147,682)	(2,141,264)	(1,364,269)	1,568,404	(518,119)
合併個體變動影響數	(1,472,581)	-	-	-	-
年初現金及約當現金餘額	147,886,955	171,276,341	194,613,752	94,986,488	117,837,192
年底現金及約當現金餘額	$ 143,472,277	$ 147,886,955	$ 171,276,341	$ 194,613,752	$ 94,986,488
現金流量資訊之補充揭露					
支付利息	$ 531,518	$ 392,805	$ 580,376	$ 676,318	$ 922,079
支付所得稅	$ 7,677,085	$ 9,818,418	$ 8,088,124	$ 10,477,018	$ 7,585,727
同時影響現金及非現金項目之投資及融資活動：					
購置固定資產價款	$ 207,175,565	$ 201,696,476	$ 109,151,226	$ 60,978,527	$ 78,889,954
應付工程及設備款減少（增加）	6,846,682	(14,599,987)	(21,361,340)	(1,742,041)	5,111,031
換出資產抵減價款	(3,164)	(124,746)	(809)	-	-
其他負債增加	(56,562)	(27,540)	-	-	-
應付租賃款增加	-	-	(4,171)	(13,832)	-
支付現金金額	$ 213,962,521	$ 186,944,203	$ 87,784,906	$ 59,222,654	$ 84,000,985
購買備供出售金融資產價款	$ 35,024,974	$ 48,405,875	$ -	$ -	$ -
應付費用及其他流動負債減少（增加）	63,420	(65,541)	-	-	-
支付現金金額	$ 35,088,394	$ 48,340,334	$ -	$ -	$ -
處分固定資產及其他資產價款	$ 543,219	$ 458,561	$ 25,050	$ 194,940	$ -
其他金融資產減少（增加）	158,000	(218,291)	-	-	-
換出資產抵減價款	(3,164)	(124,746)	(809)	-	-
取得現金金額	$ 698,055	$ 115,524	$ 24,241	$ 194,940	$ -
買回庫藏股票	$ -	$ -	$ -	$ 30,427,413	$ 48,466,957
應付費用及其他流動負債減少（增加）	-	-	-	3,053,584	(3,053,584)
支付現金金額	$ -	$ -	$ -	$ 33,480,997	$ 45,413,373
不影響現金流量之融資活動：					
一年內到期之長期負債	$ 4,562,500	$ 241,407	$ 949,298	$ 8,222,398	$ 280,813
一年內到期之其他長期應付款（帳列應付費用及其他流動負債）	$ 3,399,855	$ 1,406,601	$ 4,005,307	$ 1,126,546	$ 3,735,875

聯絡資訊

公司總部及晶圓十二廠
300-78新竹科學工業園區力行六路8號
電話：886-3-5636688　　傳真：886-3-5637000

晶圓二廠、五廠
300-77新竹科學工業園區園區三路121號
電話：886-3-5636688　　傳真：886-3-5781546

晶圓三廠
300-77新竹科學工業園區研新一路9號
電話：886-3-5636688　　傳真：886-3-5781548

晶圓六廠
741-44台南科學工業園區南科北路1號
電話：886-6-5056688　　傳真：886-6-5052057

晶圓八廠
300-78新竹科學工業園區力行路25號
電話：886-3-5636688　　傳真：886-3-5662051

晶圓十四廠
741-44台南科學工業園區南科北路1號之1
電話：886-6-5056688　　傳真：886-6-5051262

晶圓十五廠
428-81台中市大雅區科雅六路1號
電話：886-4-27026688　　傳真：886-4-25607548

北美子公司
2585 Junction Avenue, San Jose, CA 95134, U.S.A.
電話：408-3828000　　傳真：408-3828008

歐洲子公司
World Trade Center, Zuidplein 60, 1077 XV
Amsterdam The Netherlands
電話：31-20-3059900　　傳真：31-20-3059911

日本子公司
21F, Queen's Tower C, 2-3-5, Minatomirai, Nishi-ku
Yokohama, Kanagawa, 220-6221, Japan
電話：81-45-6820670　　傳真：81-45-6820673

台積電（中國）有限公司
上海市松江區文翔路4000號
郵政編碼：201616
電話：86-21-57768000　　傳真：86-21-57762525

台積電韓國有限會社
15F, AnnJay Tower, 718-2, Yeoksam-dong, Gangnam-gu Seoul 135-080, Korea
電話：82-2-20511688　　傳真：82-2-20511669

印度聯絡處
1st Floor, Pine Valley, Embassy Golf-Links Business Park
Bangalore-560071, India
電話：91-80-41768615　　傳真：91-80-41764568

加拿大子公司
535 Legget Dr, Suite 600, Kanata, ON K2K 3B8
Canada
電話：1-613-576-1990　　傳真：1-613-576-1999

公司發言人
姓名：何麗梅
職稱：資深副總經理暨財務長
電話：886-3-5054602　　傳真：886-3-5670121
電子信箱：cyhsu@tsmc.com

代理發言人／法人關係
姓名：孫又文
職稱：企業訊息處處長
電話：886-3-5682080　　傳真：886-3-5797337
電子信箱：elizabeth_sun@tsmc.com

簽證會計師
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名：林鴻鵬、黃樹傑
105-96台北市民生東路三段156號12樓
電話：886-2-25459988　　傳真：886-2-25459966
網址：http://www.deloitte.com.tw

辦理股票過戶機構
中國信託商業銀行股務代理部
100-08台北市重慶南路一段83號5樓
電話：886-2-21811911　　傳真：886-2-23116723
網址：http://www.chinatrust.com.tw

ADR美國存託憑證存託銀行
Company: Citibank, N.A.
Depositary Receipts Services
Address: 388 Greenwich Street, New York, NY 10013, U.S.A.
Website: http://www.citigroup.com/adr
Tel: 1-877-2484237 (toll free)
Tel: 1-781-5754555 (out of US)
Fax: 1-201-3243284
E-mail: citibank@shareholders-online.com
台積公司的美國存託憑證（ADR）在美國紐約證券交易所（NYSE）以TSM為代號掛牌交易。查詢海外有價證券資訊之方式：http://www.nyse.com以及http://newmops.tse.com.tw

Safe Harbor Notice:
The statements included in this business overview that are not historical in nature are "forward-looking statements" within the meaning of the "safe harbor" provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. TSMC cautions readers that forward-looking statements are subject to significant risks and uncertainties and are based on TSMC's current expectations. Actual results may differ materially from those contained in such forward-looking statements for a variety of reasons including, among others, risks associated with cyclicality and market conditions in the semiconductor industry; demand and supply for TSMC's foundry manufacturing capacity in particular and for foundry manufacturing capacity in general; intense competition; the failure of one or more significant customers to continue to place the same level of orders with us; TSMC's ability to remain a technological leader in the semiconductor industry; TSMC's ability to manage its capacity; TSMC's ability to obtain, preserve and defend its intellectual property rights; natural disasters and other unexpected events which may disrupt production; and exchange rate fluctuations. Additional information as to these and other risk factors that may cause TSMC's actual results to differ materially from TSMC's forward-looking statements may be found in TSMC's Annual Report on Form 20-F, filed with the United States Securities and Exchange Commission (the "SEC") on April 15, 2012, and such other documents as TSMC may file with, or submit to, the SEC from time to time. Except as required by law, we undertake no obligation to update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events, or otherwise.

本營運報告著作人為台灣積體電路製造股份有限公司，並保留所有著作權法上之權利。

台灣積體電路製造股份有限公司
300-78新竹科學工業園區力行六路8號
電話：886-3-5636688　傳真：886-3-5637000
http://www.tsmc.com